

A. 有關本集團的其他資料

1. 本公司的註冊成立

本公司於2000年7月11日在中國註冊成立，並於2008年4月28日改制為股份有限公司。本公司於2010年2月11日完成A股於深圳證券交易所創業板的上市(股份代號：300054)。

截至本文件日期，本公司的註冊地址及總部均位於中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東荊河路1號。本公司的公司架構及公司章程受中國法律及法規規管。

我們的香港註冊營業地點位於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。我們於2026年4月8日根據公司條例第16部註冊為一家非香港公司。馮羨婷女士已獲委任為本公司授權代表，以於香港代表本公司接收法律程序文件。送達法律程序文件的地址與我們在香港的主要營業地點相同。

2. 本公司股本變動

除下文及「歷史及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

- (i) 於2025年5月至2026年6月期間，由於根據2024年購股權激勵計劃行使購股權，本公司總股本增加了14,960,889股A股。
- (ii) 於2025年10月至2026年6月期間，由於合共4,356份可換股債券進行換股，本公司總股本增加了15,201股A股。

3. 我們附屬公司的股本變動

公司資料概要及主要附屬公司詳情載於本文件附錄一會計師報告附註I。

- (i) 於2025年4月2日，鼎龍匯盛的註冊資本由人民幣20百萬元增至人民幣200百萬元。
- (ii) 於2025年9月26日，柔顯(仙桃)光電半導體的註冊資本由人民幣80百萬元增加至人民幣160百萬元。
- (iii) 於2025年9月29日，鼎龍(仙桃)新材料的註冊資本由人民幣100百萬元增加至人民幣220百萬元。

附錄六

法定及一般資料

- (iv) 於2025年10月27日，鼎龍新材料的註冊資本由人民幣20百萬元增加至人民幣70百萬元。
- (v) 於2026年2月23日，DINGTEK (MALAYSIA) SDN. BHD.的註冊資本由47百萬林吉特增加至51百萬林吉特。
- (vi) 於2026年5月27日，武漢奧特賽德科技有限公司的註冊資本由人民幣300百萬元減少至人民幣30百萬元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何附屬公司的股本概無變動。

4. 股東決議案

根據2026年4月24日召開的股東大會，下列決議案(其中包括)獲正式通過：

- (i) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，並於聯交所[編纂]；
- (ii) 於[編纂]獲行使前根據[編纂]將予發行的H股數目不得超過本公司於[編纂]完成後經擴大股本的[編纂]%，且[編纂]不得超過[編纂]項下初步將予[編纂]的H股總數的[編纂]%；
- (iii) 待[編纂]完成後，將有條件通過於[編纂]生效的公司章程，而董事會及其授權人士已獲授權根據有關監管機構的任何意見修訂公司章程；及
- (iv) 授權董事會及其獲授權人士處理與(其中包括)H股[編纂]、[編纂]及[編纂]有關的事宜。

附錄六

法定及一般資料

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合約概要

我們於緊接本文件日期前兩年內[已訂立]以下屬重大或可能屬重大的合約(並非於一般業務過程中訂立的合約)：

(i) [編纂]。

2. 知識產權

(i) 商標

(a) 已註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類型	註冊號碼	屆滿日期
1.		中國	本公司	5	18248897	2037年2月13日
2.		中國	本公司	38	18248900	2037年2月6日
3.		中國	本公司	40	18248899	2037年2月6日
4.		中國	本公司	1、2、9、17	51365733	2032年1月27日
5.		中國	本公司	3	34112683	2029年8月6日
6.		中國	本公司	10	18248898	2036年12月13日
7.		中國	本公司	2、9、16	67269977	2033年3月13日
8.		中國	本公司	16	21408816	2027年11月20日
9.	DINGLONG	中國	本公司	7	20192881	2027年10月13日
10.		中國	本公司、 鼎匯微電子	7	47875729	2031年2月20日
11.		中國	本公司、 鼎匯微電子	35	47877464	2031年2月20日

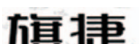
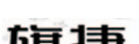
附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類型	註冊號碼	屆滿日期
12.		中國	本公司、 鼎匯微電子	7	47859066	2031年2月20日
13.		中國	本公司、 鼎匯微電子	35	47886523	2031年2月20日
14.		中國	本公司、 柔顯科技	1	31997703	2029年7月13日
15.		中國	本公司、 柔顯科技	2	32726459	2029年6月13日
16.		中國	柔顯科技	2	45958365	2032年2月6日
17.		中國	柔顯科技	2、9、17、35	45986180A	2031年3月13日
18.		中國	柔顯科技	1、2、9、17、 35	51234203A	2031年8月27日
19.		中國	柔顯科技	1、2、9、17、 35	51242013A	2031年8月27日
20.		巴西；越南	旗捷科技	9	1617569	2031年8月13日
21.		美國	旗捷科技	2、9	6213434	2030年12月8日
22.		日本	旗捷科技	2、16、35	6279522	2030年8月12日
23.		日本	旗捷科技	9	6234764	2030年3月11日
24.		歐盟；英國； 美國； 俄羅斯	旗捷科技	2、9	1474960	2028年12月17日
25.		中國	旗捷科技	2	20756524	2027年9月20日
26.		中國	旗捷科技	9	20756885	2027年9月13日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類型	註冊號碼	屆滿日期
27.		中國	旗捷科技	42	20757166	2027年9月20日
28.		中國	旗捷科技	9	6924961	2030年8月6日
29.		中國	旗捷科技	2	18731125	2027年2月6日
30.		中國	旗捷科技	42	18731451	2027年2月6日
31.		中國	旗捷科技	9	20756290	2027年9月13日
32.		中國	旗捷科技	2	20756267	2027年9月13日
33.		中國	旗捷科技	42	20756838	2027年9月13日

(b) 申請中商標

截至最後實際可行日期，我們已申請以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	申請人	類型	申請地點	申請日期	申請編號
1		本公司	1、2、3、7、 9、16、17、 35	香港	2026年3月18日	307220295

附錄六

法定及一般資料

(ii) 專利

(a) 已註冊專利

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的已註冊專利：

編號	擁有人	專利	專利類型	專利編號	申請日期	屆滿日期	註冊地點
1.	本公司	一種拋光墊及用於製備拋光墊的方法	發明	CN201711353073.9	2017年12月15日	2037年12月14日	中國
2.	本公司	耐候性拋光墊	發明	US15/233922	2016年8月10日	2037年3月27日	美國
3.	本公司	一種拋光墊	發明	CN201611011643.1	2016年11月17日	2036年11月16日	中國
4.	本公司	化學機械拋光墊的檢測窗及其製備方法	發明	CN201610390615.9	2016年6月3日	2036年6月2日	中國
5.	本公司	一種聚鹽亞胺的合成方法	發明	CN201510733059.6	2015年11月2日	2035年11月1日	中國
6.	本公司	丙烯酸樹脂和用該樹脂包覆的載體、及雙組分顯影劑	發明	CN201510700240.7	2015年10月23日	2035年10月22日	中國
7.	本公司	彩色碳粉及其製備方法	發明	US13/845153	2013年3月18日	2033年4月15日	美國
8.	本公司	靜電圖像顯影劑用載體的製造方法	發明	CN201210052732.6	2012年3月2日	2032年3月1日	中國
9.	本公司	雙組分顯影劑	發明	US13/178496	2011年7月8日	2031年6月12日	美國
10.	本公司	彩色碳粉及其製備方法	發明	EP2010734886	2010年5月4日	2030年5月3日	歐洲

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	擁有人	專利	專利類型	專利編號	申請日期	屆滿日期	註冊地點
11.	本公司	靜電荷顯影用碳粉的製造方法	發明	CN200810048434.3	2008年7月17日	2028年7月16日	中國
12.	本公司	靜電荷顯影用碳粉及其製造方法	發明	CN200810047016.2	2008年3月6日	2028年3月5日	中國
13.	本公司； 鼎龍芯盛科技； 鼎龍(潛江)新材料； 鼎匯微電子	一種含氟樹脂粉末、包含其的光致抗蝕劑組合物及其製備方法和應用	發明	CN202511205103.6	2025年8月27日	2045年8月26日	中國
14.	本公司；鼎澤(仙桃)； 鼎澤新材料技術； 鼎龍(仙桃)新材料	半導體器件的製造方法、硅溶膠及其製備方法和研磨用組合物	發明	CN202510163022.8	2025年2月14日	2045年2月13日	中國
15.	本公司；鼎匯微電子； 鼎龍匯盛	拋光層，拋光墊及拋光方法	發明	CN202510005327.6	2025年1月2日	2045年1月1日	中國
16.	本公司；鼎澤新材料技術；鼎匯微電子	化學機械拋光後清洗組合物及半導體器件基板的清洗方法	發明	CN202310501171.1	2023年4月28日	2043年4月27日	中國
17.	本公司；鼎匯微電子； 鼎澤新材料技術	一種拋光墊	發明	CN202111506323.4	2021年12月10日	2041年12月9日	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	專利	專利類型	專利編號	申請日期	屆滿日期	註冊地點
18.	本公司；鼎匯微電子； 長鑫存儲技術 有限公司	一種拋光墊	發明	CN202110087557.3	2021年1月22日	2041年1月21日	中國
19.	本公司；柔顯科技	聚醯亞胺前體、聚 醯亞胺薄膜及其 製備方法以及顯 示裝置	發明	CN202011456977.6	2020年12月10日	2040年12月9日	中國
20.	本公司；柔顯科技	聚醯亞胺共聚物前 體、聚醯亞胺以 及聚醯亞胺薄膜 的製備方法	發明	CN201811563637.6	2018年12月20日	2038年12月19日	中國
21.	本公司；鼎龍匯盛； 鼎匯微電子； 鼎澤新材料技術	拋光墊及研磨設備	發明	CN201810738877.9	2018年7月6日	2038年7月5日	中國
22.	本公司；鼎匯微電子	拋光墊及半導體元 件的製造方法	發明	KR1020220117559	2022年9月19日	2042年9月18日	韓國
23.	本公司；鼎匯微電子	拋光墊的製備方法	發明	CN201810528347.1	2018年5月28日	2038年5月27日	中國
24.	鼎匯微電子	拋光墊及半導體元 件的製造方法	發明	TW112145705	2023年11月24日	2043年11月22日	中國台灣
25.	鼎匯微電子	拋光墊、拋光層、多 元胺組合物	發明	TW112115391	2023年4月25日	2043年4月23日	中國台灣

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	擁有人	專利	專利類型	專利編號	申請日期	屆滿日期	註冊地點
26.	鼎匯微電子	基於多孔氧化鉀之化學機械研磨層及其製備方法	發明	US16/186575	2018年11月11日	2039年5月20日	美國
27.	鼎匯微電子	聚胺酯研磨層、含研磨層之研磨墊、研磨層之製造方法及材料平坦化方法	發明	KR1020207005721	2018年8月31日	2038年8月30日	韓國
28.	鼎匯微電子	一種超硬脆工件的研磨拋光方法	發明	CN201610857938.4	2016年9月28日	2036年9月27日	中國
29.	旗捷科技	耗材芯片、具有其的耗材盒及耗材芯片的製作方法	發明	US18/098715	2023年1月19日	2042年7月17日	美國
30.	旗捷科技	墨盒測試設備、墨盒組件及墨盒組件測試方法	發明	US17/861262	2022年7月11日	2041年9月1日	美國
31.	旗捷科技	再生芯片的控制方法、再生芯片和再生墨盒	發明	EP2021822814	2021年4月2日	2041年4月1日	歐洲
32.	旗捷科技	修復芯片、墨盒和打印機	發明	EP2020899508	2020年12月11日	2040年12月10日	歐洲

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	擁 有 人	專 利	專 利 類 型	專 利 編 號	申 請 日 期	屆 滿 日 期	註 冊 地 點
33.	旗捷科技	耗材芯片通信方法、 耗材芯片級耗材	發明	US17/441277	2020年6月17日	2040年8月7日	美國
34.	旗捷科技	耗材芯片的自動 復位方法、耗材 芯片	發明	EP2020822275	2020年4月27日	2040年4月26日	歐洲
35.	旗捷科技	一種耗材芯片、 耗材芯片通信 方法	發明	EP2020745015	2020年1月13日	2040年1月12日	歐洲
36.	旗捷科技	耗材芯片、耗材、 耗材通信方法	發明	US16/475880	2018年8月10日	2038年8月9日	美國
37.	旗捷科技	耗材芯片數據改寫 設備	發明	EP2017915974	2017年7月19日	2037年7月18日	歐洲
38.	旗捷科技	再生墨盒、再生芯 片、打印機系統 通信方法、墨盒 再生方法	發明	EP2016891986	2016年3月2日	2036年3月1日	歐洲
39.	旗捷科技	再生墨盒的修復方 法、修復芯片和 再生墨盒	發明	EP2015911044	2015年12月22日	2035年12月21日	歐洲
40.	旗捷科技	再生墨盒的修復方 法、修復芯片和 再生墨盒	發明	CN201510966214.9	2015年12月22日	2035年12月21日	中國

附錄六

法定及一般資料

(b) 申請中專利

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的專利：

編號	申請人	專利	專利類型	申請編號	申請日期	註冊地點
1.	本公司	多層核殼結構化學碳粉及其製備方法	發明	CN202511212649.4	2025年8月28日	中國
2.	本公司；鼎龍匯盛；鼎匯微電子	化學機械拋光墊及其製備方法	發明	CN202511853462.2	2025年12月10日	中國
3.	本公司；鼎龍匯盛；鼎匯微電子	化學機械拋光墊緩衝層、製備方法、拋光墊及應用	發明	CN202511648191.7	2025年11月12日	中國
4.	本公司；柔顯科技；柔顯(仙桃)光電半導體	感光樹脂組合物、固化膜和彩色遮光層	發明	CN202511340603.0	2025年9月19日	中國
5.	本公司；柔顯科技；柔顯(仙桃)光電半導體	感光樹脂組合物、固化膜、圖案固化膜及其應用	發明	CN202511233007.2	2025年9月1日	中國
6.	本公司；柔顯科技；柔顯(仙桃)光電半導體	一種液晶取向劑、液晶取向膜和液晶表示元件	發明	CN202510880408.0	2025年6月27日	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	申請人	專利	專利類型	申請編號	申請日期	註冊地點
7.	本公司； 鼎龍(潛江)新材料； 鼎龍芯盛科技	鎢鹽化合物、抗蝕劑組合物及圖案形成方法	發明	CN202510664964.4	2025年5月22日	中國
8.	本公司；鼎澤新材料 技術；鼎澤(仙桃)； 鼎龍(仙桃)新材料	一種用於多晶硅的化學機械拋光組合物、拋光方法	發明	CN202510476194.0	2025年4月16日	中國
9.	本公司；鼎澤新材料 技術；鼎澤(仙桃)； 鼎龍新材料	一種氧化銻粉體、製備方法及化學機械拋光液	發明	CN202510436429.3	2025年4月9日	中國
10.	本公司；鼎澤新材料 技術；鼎澤(仙桃)； 鼎龍新材料	一種碳化硅襯底粗拋用酸性氧化鋁拋光組合物及拋光方法	發明	CN202510399868.1	2025年4月1日	中國
11.	本公司；鼎龍 芯盛科技；鼎龍 (潛江)新材料； 鼎匯微電子	一種光致抗蝕劑組合物及其圖案形成方法	發明	CN202411898423.X	2024年12月23日	中國
12.	本公司；鼎匯微電子； 鼎龍(仙桃)新材料	一種熱膨脹微球及其製備方法	發明	CN202411804315.1	2024年12月10日	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	申請人	專利	專利類型	申請編號	申請日期	註冊地點
13.	本公司； 鼎龍(潛江)新材料； 鼎龍芯盛科技	鎔鹽類化合物、光致產酸劑、包含其的光致抗蝕劑組合物	發明	CN202410644528.6	2024年5月23日	中國
14.	本公司；鼎澤新材料技術	化學機械拋光後清洗組合物及清洗方法	發明	CN202410518901.3	2024年4月28日	中國
15.	本公司；柔顯科技	感光樹脂組合物、圖案固化膜的製造方法、固化膜及其應用	發明	CN202310792181.5	2023年6月29日	中國
16.	本公司；鼎匯微電子； 鼎龍匯盛	檢測窗口、拋光墊及拋光系統	發明	CN202310538633.7	2023年5月15日	中國
17.	旗捷科技	芯片及其控制方法	發明	CN202511556018.4	2025年10月28日	中國
18.	旗捷科技	芯片短路校驗方法、裝置、芯片檢測方法、芯片和耗材盒	發明	EP2024777822	2024年3月20日	歐洲

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	申請人	專利	專利類型	申請編號	申請日期	註冊地點
19.	旗捷科技	芯片短路校驗方法、裝置、芯片檢測方法、芯片和耗材盒	發明	JP2025556693	2024年3月20日	日本
20.	旗捷科技	芯片短路校驗方法、裝置、芯片檢測方法、芯片和耗材盒	發明	US19/339871	2025年9月25日	美國
21.	旗捷科技	一種升級方法、裝置、升級設備及升級系統	發明	CN202511323957.4	2025年9月16日	中國
22.	旗捷科技	打印耗材裝置、打印耗材和打印耗材裝置通訊方法	發明	CN202511312801.6	2025年9月12日	中國
23.	旗捷科技	耗材芯片、具有其的耗材盒以及耗材芯片的製作方法	發明	US19/169053	2025年4月3日	美國
24.	旗捷科技	數據存儲方法、裝置、設備、存儲介質、計算機程序產品	發明	CN202411533216.4	2024年10月30日	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	申請人	專利	專利類型	申請編號	申請日期	註冊地點
25.	旗捷科技	耗材晶片、耗材晶片控制方法和打印耗材	發明	CN202411449339.X	2024年10月16日	中國
26.	旗捷科技	一種時鐘控制方法、安全晶片、設備及存儲介質	發明	CN202410398612.4	2024年4月2日	中國
27.	旗捷科技	耗材認證方法、裝置、系統、耗材晶片及打印耗材	發明	CN202410211621.8	2024年2月26日	中國
28.	旗捷科技	固件升級方法、裝置、系統、設備及存儲介質	發明	CN202410095124.6	2024年1月23日	中國
29.	旗捷科技	耗材晶片、工作方法及耗材盒	發明	CN202311843202.8	2023年12月27日	中國
30.	旗捷科技	晶片短路校驗方法、裝置、晶片檢測方法、晶片和耗材盒	發明	CN202311737080.4	2023年12月15日	中國
31.	旗捷科技	晶片短路校驗方法、晶片和墨水匣	發明	CN202310882117.6	2023年7月18日	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	申請人	專利	專利類型	申請編號	申請日期	註冊地點
32.	旗捷科技	認證方法、認證裝置與系統	發明	CN202310683803.0	2023年6月8日	中國
33.	旗捷科技	安全通訊方法、晶片、設備及可讀存儲介質	發明	CN202310456661.4	2023年4月24日	中國
34.	旗捷科技	時鐘頻率檢測電路及晶片	發明	CN202310436342.7	2023年4月17日	中國
35.	旗捷科技	耗材芯片、具有其的耗材盒以及耗材芯片的製作方法	發明	EP2022844821	2022年1月29日	歐洲
36.	旗捷科技	打印機耗材芯片升級系統、方法以及耗材容器	發明	EP2021745077	2021年1月20日	歐洲
37.	旗捷科技	一種耗材晶片通訊方法、耗材晶片及耗材	發明	CN201910635752.8	2019年7月15日	中國

附錄六

法定及一般資料

(iii) 著作權

截至最後實際可行日期，我們為以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的軟件著作權的註冊所有人：

編號	軟件	擁有人	註冊號碼	註冊地點
1.	鼎龍智慧園區系統軟件	本公司	2024SR0027540	中國
2.	旗捷無源RF標籤量產系統軟件	旗捷科技	2025SR0203121	中國
3.	旗捷硬件安全領域的動態數據 簽名軟件	旗捷科技	2025SR0620052	中國
4.	旗捷芯片動態功耗控制功耗軟件	旗捷科技	2025SR0701356	中國
5.	旗捷基於AHB總線高速代碼自動 生成軟件	旗捷科技	2024SR0165872	中國
6.	旗捷打印耗材芯片測試解析軟件	旗捷科技	2024SR0960249	中國
7.	旗捷芯片數據無線升級軟件	旗捷科技	2024SR1269658	中國
8.	旗捷硬件安全領域的數據 簽名軟件	旗捷科技	2024SR1268758	中國
9.	旗捷數字企業芯片產品檔案管理 系統軟件	旗捷科技	2023SR1233108	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	軟件	擁有人	註冊號碼	註冊地點
10.	旗捷硬件安全領域通信的數據解析分類軟件	旗捷科技	2023SR1479937	中國
11.	旗捷邏輯分析儀IIC協議導出文本解析軟件	旗捷科技	2022SR0092009	中國
12.	旗捷與加密芯片通訊軟件	旗捷科技	2022SR0092007	中國
13.	旗捷CJ28E22燒錄軟件	旗捷科技	2022SR1076775	中國
14.	旗捷數字化工廠APP軟件	旗捷科技	2022SR1427456	中國
15.	旗捷智能雲升級終端軟件	旗捷科技	2021SR1133272	中國
16.	旗捷RFID打印耗材芯片通信協議分析軟件	旗捷科技	2020SR1577646	中國
17.	旗捷打印耗材芯片通信協議分析軟件	旗捷科技	2020SR1570031	中國
18.	旗捷噴墨打印耗材芯片通信分析軟件	旗捷科技	2020SR1570032	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	軟件	擁有人	註冊號碼	註冊地點
19.	旗捷激光打印耗材芯片控制軟件	旗捷科技	2017SR429062	中國
20.	旗捷基於I2C協議的打印耗材芯片通信軟件	旗捷科技	2017SR434489	中國
21.	旗捷再生式打印初始數據復位改寫軟件	旗捷科技	2016SR090007	中國
22.	旗捷五十連片耗材寫讀碼儀控制軟件	旗捷科技	2016SR089597	中國
23.	旗捷再生式打印數據檢測改寫軟件	旗捷科技	2016SR322430	中國
24.	旗捷基於I2C協議的打印耗材芯片通信軟件	旗捷科技	2016SR322275	中國
25.	旗捷打印耗材芯片單線通信協議軟件	旗捷科技	2016SR321759	中國
26.	旗捷打印耗材芯片數據遠程更新軟件	旗捷科技	2016SR345707	中國
27.	旗捷再生式打印初始數據復位改寫軟件	旗捷科技	2016SR345941	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	軟件	擁 有 人	註冊號碼	註冊地點
28.	旗捷打印耗材芯片控制軟件	旗捷科技	2012SR000803	中國
29.	旗捷打印耗材芯片的傳感器電路 檢測軟件	旗捷科技	2012SR028000	中國
30.	旗捷打印耗材芯片仿真測試軟件	旗捷科技	2012SR027996	中國
31.	旗捷打印耗材芯片外置式初始 數據復位軟件	旗捷科技	2012SR027990	中國
32.	旗捷打印耗材芯片在線式初始 數據恢復軟件	旗捷科技	2012SR027993	中國
33.	旗捷耗材寫碼儀控制軟件	旗捷科技	2009SR031871	中國
34.	旗捷耗材檢測儀控制軟件	旗捷科技	2009SR031872	中國
35.	旗捷十連片耗材寫碼儀控制軟件	旗捷科技	2009SR031875	中國
36.	旗捷打印耗材芯片控制軟件	旗捷科技	2008SR18258	中國
37.	旗捷打印耗材芯片控制軟件	旗捷科技	2007SR13788	中國

附錄六

法定及一般資料

(iv) 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	擁有人
1.	www.dl-kg.com	本公司

C. 有關我們的董事、最高行政人員及主要股東的其他資料

1. 董事及最高行政人員的權益披露

下文載列緊隨[編纂]完成後(假設(i)[編纂]未獲行使，及(ii)自最後實際可行日期起及直至[編纂]本公司已發行股本總額並無其他變動，且不包括因可換股債券獲轉換而可能發行的任何A股)，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益(包括根據《證券及期貨條例》有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條須於該條所指登記冊內登記的權益，或根據上市規則所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所的權益：

(i) 於本公司的權益

姓名	職務	權益性質	股份數目及描述	緊隨[編纂] 完成後 於本公司 的股權 概約百分比
				[編纂]%
朱雙全先生 ⁽¹⁾	董事長及 執行董事	實益擁有人	139,249,514股 A股	[編纂]%
		一致行動人士權益	138,031,414股 A股	[編纂]%
朱順全先生 ⁽¹⁾	執行董事兼 總經理	實益擁有人	138,031,414股 A股	[編纂]%
		一致行動人士權益	139,249,514股 A股	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

緊隨[編纂]
完成後
於本公司
的股權

姓名	職務	權益性質	股份數目及描述	概約百分比
姚紅女士 ⁽²⁾	執行董事兼 首席財務官	實益擁有人	381,250股 A股	[編纂]%
楊平彩女士 ⁽³⁾	執行董事、 副總經理及 董事會秘書	實益擁有人	442,500股 A股	[編纂]%
楊波博士	非執行董事	實益擁有人	560,084股 A股	[編纂]%
羅德日先生 ⁽⁴⁾	非執行董事兼 職工代表董事	實益擁有人	114,630股A股	[編纂]%

附註：

- (1) 有關朱雙全先生及朱順全先生所持權益之詳情，請參閱「主要股東」一節。
- (2) 截至最後實際可行日期，姚紅女士(i)直接持有本公司306,250股A股，及(ii)有權根據2024年購股權激勵計劃授予其之購股權認購本公司75,000股A股，惟須符合其相關條件。
- (3) 截至最後實際可行日期，楊平彩女士(i)直接持有本公司327,500股A股，及(ii)根據2024年購股權激勵計劃授予其之購股權，有權認購本公司115,000股A股，惟須符合其相關條件。
- (4) 截至最後實際可行日期，羅德日先生(i)直接持有本公司84,630股A股，及(ii)有權根據2024年購股權激勵計劃獲授予的購股權認購本公司30,000股A股，惟須符合相關條件。

附錄六

法定及一般資料

2. 主要股東的權益披露

(i) 於本公司的權益

除「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設(i)[編纂]未獲行使，及(ii)自最後實際可行日期起及直至[編纂]本公司已發行股本總額並無其他變動，且不包括因可換股債券獲轉換而可能發行的任何A股)，董事概不知悉任何其他人士(並非董事或本公司最高行政人員)將於股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有任何類別股本面值10%或以上的權益，而該股本附帶權利可在任何情況下於本公司股東大會上投票。

(ii) 於本集團其他成員公司的權益

據董事所知，截至最後實際可行日期，以下人士(本集團成員公司、董事或本公司最高行政人員除外)於本集團成員公司任何類別股本面值中擁有10%或以上權益，而該股本附有權利於所有情況下在該成員公司股東大會上投票：

本集團成員		主要股東
公司名稱	主要股東名稱	持有的表決權 概約百分比
皓飛新材	侯玲玲	15.86%
鼎澤新材料技術	TOPSCIENCE TECHNOLOGY PTE. LTD.	10.00%
鼎龍(潛江)新材料	寧波百誠企業管理合夥企業 (有限合夥)	10.53%
	寧波晶和企業管理合夥企業 (有限合夥)	10.53%
湖北鼎英材料科技 有限公司	武漢欲信恒企業管理合夥企業 (有限合夥)	27.14%

附錄六

法定及一般資料

本集團成員 公司名稱		主要股東 持有的表決權 概約百分比
浙江執一半導體 有限公司	寧波晶亦求晶自有資金投資合夥企業 (有限合夥)	29.00%
	王志萍	20.00%

3. 服務合約詳情

本公司[已與]每名董事訂立服務合約。該等服務合約的主要細節為：(i)各合約自其任期開始日期起計為期三年；及(ii)各合約可根據其各自條款予以終止。服務合約可根據本公司章程及不時適用的法律、規則及規例重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約(於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

4. 董事之酬金

除本文件「董事及高級管理層」一節及本文件附錄一所載會計師報告附註10所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止各年度以及截至2026年4月30日止四個月，概無董事自我們收取其他酬金或實物福利。

5. 免責聲明

除本附錄所披露者外，本公司董事或「E.其他資料 — 7.專家資格及同意書」一節所列任何當事方均無：

- (i) 於我們的發起，或於緊接本文件日期前兩年內由我們收購或出售或租賃予我們，或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
- (ii) 於本文件日期仍然生效且對本公司業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；

D. 2024年購股權激勵計劃

以下為截至最後實際可行日期有效的2024年購股權激勵計劃之主要條款概要。2024年購股權激勵計劃的條款不涉及本公司於[編纂]後授予任何股份激勵，且不受上市規則第十七章條文的約束。

1. 目的

2024年購股權激勵計劃之目的，旨在建立及完善本公司的長期激勵機制，吸引及留住優秀人才，並透過將股東、本公司及核心團隊成員的利益相結合，充分調動董事、高級管理人員、核心技術及管理人員的積極性，從而支持本公司的長期發展，同時保障股東利益，並將獎勵與表現及貢獻掛鉤。

2. 管理

2024年購股權激勵計劃須經本公司股東大會批准，並將由董事會實施及管理。薪酬與考核委員會負責擬訂及修訂2024年購股權激勵計劃，並將其提交董事會審議。

3. 合資格參與者

2024年購股權激勵計劃的合資格參與者包括本公司的董事、高級管理人員以及核心技術及管理人員，但不包括(i)獨立非執行董事、(ii)單獨或合計持有本公司5%或以上股份的股東、實際控制人及其各自的配偶、父母及子女，以及(iii)境外僱員。於2024年購股權激勵計劃有效期內，所有合資格參與者必須與本公司或其附屬公司維持僱傭或服務關係。

4. 股份來源及數目上限

2024年購股權激勵計劃的標的股份應為本公司向合資格參與者發行的A股。

受限於計劃規則的調整機制，2024年購股權激勵計劃項下初步可供授予的股份最高數目為25,000,000股A股。根據本公司目前生效的所有股份激勵計劃，授予任何個別承授人的股份數目，不得超過本公司總股本的1%。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

5. 授 予 日 期 及 有 效 期

購股權的授予日期應為董事會於2024年購股權激勵計劃獲股東大會批准後60日內所確定的深圳證券交易所交易日。購股權的授予應由董事會批准，且相關登記及公告程序應在上述60日期限內完成。

2024年購股權激勵計劃應自購股權授予日期起生效，直至根據該計劃授予的所有購股權均已行使或註銷之日止，惟2024年購股權激勵計劃的有效期不得超過48個月。

6. 歸 屬 及 行 使 時 間 表

購股權的歸屬期應自購股權的授予日期起至購股權變為可行使之日止。根據2024年購股權激勵計劃授予的購股權，其歸屬期分別為自授予日期起計12個月、24個月及36個月，且於各相關期間屆滿時分別有40%、30%及30%的已授出購股權完成歸屬。於歸屬期內，根據購股權激勵計劃授予參與者的購股權不得轉讓，亦不得用作擔保或償還債務。

購股權將於歸屬期後，按照下文載列的行使時間表並在達成第9段所載條件後，方可行使：

批次	行 權 期	比 例
第一個行權期	自授予日期起滿12個月後的第一個交易日起至授予日期起滿24個月內的最後一個交易日止(包括首尾兩日)	40%
第二個行權期	自授予日期起滿24個月後的第一個交易日起至授予日期起滿36個月內的最後一個交易日止(包括首尾兩日)	30%
第三個行權期	自授予日期起滿36個月後的第一個交易日起至授予日期起滿48個月內的最後一個交易日止(包括首尾兩日)	30%

已授出購股權的行使應在深圳證券交易所的交易日進行，且該交易日不得處於中國證監會和深圳證券交易所規定的任何禁止期內。倘承授人未有於上述規定期間內行使任何購股權，或相關批次之購股權因未達成行使條件而無法行使，本公司將依據2024年購股權激勵計劃條款，註銷該承授人對應未獲行使之購股權，相關權益不得結轉至其後任何期間。

附錄六

法定及一般資料

7. 禁售安排

2024年購股權激勵計劃項下的禁售安排乃根據適用中國法律法規及公司章程釐定：

- (i) 倘承授人為本公司董事或高級管理人員，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有股份總數的25%。該董事或高級管理人員所持有的股份，在其離職後六個月內不得轉讓；及
- (ii) 在2024年購股權激勵計劃有效期內，倘上述禁售規定的適用法律法規或公司章程的相關規定發生任何變化，承授人應遵守該等經修訂的要求。

8. 行使價

2024年購股權激勵計劃項下每份購股權的行使價不得低於每股A股的面值，且原則上不得低於下列較高者：

- (i) 緊接2024年購股權激勵計劃公告前一個交易日的A股交易均價；及
- (ii) 緊接2024年購股權激勵計劃公告前60個交易日的A股交易均價。

9. 授出及行使購股權的條件

購股權僅在滿足以下條件的情況下才會授予參與者：

- (i) 就本公司而言，未發生以下任一情形：
 - (a) 註冊會計師已就本公司最近一個會計年度的會計師報告出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
 - (b) 註冊會計師對最近一個會計年度會計師報告所載之內部控制報告出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
 - (c) 於深圳證券交易所上市後最近36個月內，存在未按法律法規、公司章程或公開承諾進行利潤分配的情形；及
 - (d) 適用法律法規規定不得實行股權激勵計劃；或

附錄六

法定及一般資料

- (e) 中國證監會認定的任何其他情形。
- (ii) 就承授人而言，未發生以下任一情形：
 - (a) 承授人於最近12個月內被深圳證券交易所認定為不適當人選；
 - (b) 承授人於最近12個月內被中國證監會或其派出機構認定為不適當人選；
 - (c) 承授人於最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會或其派出機構予以行政處罰或採取市場禁入措施；
 - (d) 承授人不具備根據《中國公司法》擔任董事或高級管理人員的資格；及
 - (e) 適用法律法規規定承授人不得參與上市公司股權激勵計劃；或
 - (f) 中國證監會認定的任何其他情形。

為使購股權可行使，除上述載列的條件外，承授人亦須根據2024年購股權激勵計劃的條款達成業績目標。

10. 調整

在符合2024年購股權激勵計劃的其他條款及條件以及適用法律法規的前提下，倘本公司在購股權行使前進行任何資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、股份合併或股息派付，購股權的數量及／或行使價應視情況進行相應調整。

11. 未行使購股權

截至最後實際可行日期，根據2024年購股權激勵計劃已授出的未行使購股權數目為9,280,611股，約佔緊隨[編纂]完成後(假設(i)[編纂]未獲行使，及(ii)自最後實際可行日期起及直至[編纂]本公司已發行股本總額並無其他變動，且不包括因可換股債券獲轉換而可能發行的任何A股)已發行股份的[編纂]%。倘所有該等未行使購股權獲悉數行使，假設[編纂]未獲行使，以及自最後實際可行日期起至[編纂]日期止期間本公司已發行股本並無其他變動，則股東於[編纂]後緊隨持有的已發行及發行在外股份將被攤薄約[編纂]%。對我們每股盈利造成的攤薄影響將約為[編纂]%。

附錄六

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期，根據2024年購股權激勵計劃授予所有承授人(包括董事、高級管理層成員、關連人士及本公司其他僱員)的未行使購股權詳情。合資格參與者根據2024年購股權激勵計劃獲授購股權，並無已付／應付代價。

承授人名稱	職位／ 關連關係	授予日期	地址	未行使 購股權相關 的A股數目	行使價(每股)	行使期	緊接[編纂] 完成後所佔 已發行股份的 概約百分比 ⁽¹⁾
董事或高級管理人員							
姚紅女士	執行董事兼 首席財務官	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 礄口區長豐街道翡翠城二期3棟1單元4002	75,000	人民幣18.83元	2025年5月16日 至2028年5月15日	[編纂]%
楊平彩女士	執行董事、 副總經理及 董事會秘書	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 洪山區梨橋村2區18-2號	115,000	人民幣18.83元	2025年5月16日 至2028年5月15日	[編纂]%
羅德日先生	非執行董事兼 職工代表董事	2024年5月16日	中國江西省吉安市 泰和縣萬合鎮圩鎮百姓街95號	30,000	人民幣18.83元	2025年5月16日 至2028年5月15日	[編纂]*%
黃金輝先生	副總經理	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 江漢區建設大道536-2號6樓1室	150,000	人民幣18.83元	2025年5月16日 至2028年5月15日	[編纂]%
肖桂林博士	副總經理	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 武昌區珞珈山16號	150,000	人民幣18.83元	2025年5月16日 至2028年5月15日	[編纂]%
關連人士							
魯麗平女士	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 漢陽區江城大道288號招商公園環園7棟1單元802室	180,000	人民幣18.83元	2025年5月16日 至2028年5月15日	[編纂]%
王志萍先生	附註2	2024年5月16日	中國浙江省杭州市 杭悅商業中心3幢718室	174,000	人民幣18.83元	2025年5月16日 至2028年5月15日	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

承授人名稱	職位／ 關連關係	授予日期	地址	未行使 購股權相關 的A股數目	行使價(每股)	行使期	緊接[編纂] 完成後所佔 已發行股份的 概約百分比 ⁽¹⁾
周禕女士	附註2	2024年5月16日	中國浙江省杭州市 餘杭區閑林街道竹 海水韻花園春風裡 7幢1單元1804室	107,033	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]%
王磊先生	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 漢陽區東荊河路1 號	90,000	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]%
何康先生	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢 市武昌區首義路 110-0501號	88,000	人民幣18.83元	2025年5月16日 至2028年5月15日	[編纂]%
劉敏先生	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 漢陽區百業路29號	75,000	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]%
任驥麟先生	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 江岸區同馨花園33 棟3單元301室	60,000	人民幣18.83元	2025年5月16日 至2028年5月15日	[編纂]%
王斌先生	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 礄口區解放大道584 號16棟1單元41樓 4103室	60,000	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]%
王章艷女士	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 江夏區廟山開發區 江夏大道宜家湯臣 13棟1單元601室	60,000	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]%
周波先生	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 漢陽區三角湖路35 號萬科金域藍灣F2 棟1單元2004室	60,000	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

承授人名稱	職位／ 關連關係	授予日期	地址	未行使 購股權相關 的A股數目	行使價(每股)	行使期	緊接[編纂] 完成後所佔 已發行股份的 概約百分比 ⁽¹⁾
戴遠征女士	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 江漢區萬松社區 27-1號6樓3室	54,000	人民幣18.83元	2025年5月16日 至2028年5月15日	[編纂]%
蘇敏光先生	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 洪山區卓刀泉路 271號	45,000	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]*%
劉為女士	附註2	2024年5月16日	中國湖北省恩施市 葉挺路5號2棟2單 元2室	26,000	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]*%
黃川凌先生	附註2	2024年5月16日	中國湖南省長沙縣 三一路2號	22,500	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]*%
梁飛先生	附註2	2024年5月16日	中國湖北省武漢市 洪山區白沙洲大道 8號57棟1單元1403 室	10,500	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]*%
其他僱員							
合共255名 其他僱員	核心技術及 管理人員	2024年5月16日	—	7,648,578	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]%
總計				9,280,611			[編纂]%

附註：

- (1) 假設(i)[編纂]未獲行使，及(ii)自最後實際可行日期起及直至[編纂]本公司已發行股本總額並無其他變動，且不包括因可換股債券獲轉換而可能發行的任何A股。
- (2) 均為我們附屬公司的董事、最高行政人員、監事或於過往12個月內的前董事，因此構成上市規則第14A章所定義的關連人士。

* 指少於[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期根據2024年購股權激勵計劃授予其他承授人(不包括本公司董事、高級管理人員及關連人士)的未行使購股權詳情。

						緊接[編纂] 完成後 佔已發行股份 的概約百分比 ⁽¹⁾
未行使 購股權範圍	授予日期	承授人數目	未行使 購股權相關 的A股數目	行使價(每股)	行使期	
1-10,000	2024年5月16日	60	459,000	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]%
10,001-50,000	2024年5月16日	154	3,939,863	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]%
>50,000	2024年5月16日	41	3,249,715	人民幣18.83元	2025年5月16日至 2028年5月15日	[編纂]%
總計		255	7,648,578			[編纂]%

附註：

- (1) 假設(i)[編纂]未獲行使，及(ii)自最後實際可行日期起及直至[編纂]本公司已發行股本總額並無其他變動，且不包括因可換股債券獲轉換而可能發行的任何A股。

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們的董事獲告知，本公司或其任何附屬公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，據我們所知，我們或任何董事概無涉及任何會對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響的未決或面臨威脅的其他重大訴訟或仲裁程序。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載的適用於保薦人的獨立性標準。聯席保薦人將就擔任本公司有關[編纂]的保薦人而合共獲本公司支付人民幣3百萬元的費用。

聯席保薦人已向聯交所申請批准根據[編纂]將予[編纂]的本公司H股[編纂]，並准許該等H股進行[編纂]。已作出一切必要安排，使H股獲准納入[編纂]。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

4. 籌備費用

本公司並無產生任何重大籌備費用。

5. 無重大不利變動

董事確認，自2026年4月30日(即本集團最近期綜合財務報表之編製日期)以來，本集團的財務或交易狀況或前景概無重大不利變動。

6. 發起人

本公司發起人如下：

序號	姓名／名稱
1.	朱雙全
2.	朱順全
3.	李林
4.	王斌
5.	黃金輝
6.	蘭澤冠
7.	楊波
8.	曾愛蓮
9.	左新舉
10.	魯麗平
11.	李冬生
12.	陳曦
13.	梁珏
14.	劉勝榮
15.	戴遠征
16.	饒峰
17.	朱獻民
18.	王玉賓
19.	宋軍
20.	田梅
21.	田凱軍
22.	中國寶安集團控股有限公司
23.	深圳市創新投資集團有限公司
24.	湖北省高新技術產業投資有限公司
25.	武漢科技創新投資有限公司
26.	中國風險投資有限公司

附錄六

法定及一般資料

於緊接本文件日期前兩年內，概無亦不擬就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

7. 專家資格及同意書

以下為各專家的資格，該等專家均已就本文件的刊發發出同意書，且並無撤回，同意按本文件所載形式及內容刊載其報告、函件、估值概要、估值證書及／或法律意見(視乎情況而定)及引述其名稱：

名稱	資格
招商證券(香港)有限公司	根據《證券及期貨條例》獲准從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動(定義見《證券及期貨條例》)的持牌法團
中信證券(香港)有限公司	根據《證券及期貨條例》可從事《證券及期貨條例》項下定義的第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
香港立信德豪會計師事務所有限公司	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
湖南啟元律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	獨立行業顧問
King and Wood LLP	本公司有關國際制裁法律的法律顧問

截至最後實際可行日期，除與[編纂]有關者外，上述專家概無於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益，亦無可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

8. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件將使所有有關人士受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條所有適用規定(懲罰性規定除外)約束。

9. 雙語文件

本文件的英文本及中文本乃依據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免條文而分別刊發。本文件的英文本與中文本如有任何歧義，概以英文本為準。

10. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊上生效(包括在聯交所進行交易的情況)，則出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。有關出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率為所出售或轉讓H股的代價或公平值(以較高者為準)的0.1%，由買方及賣方各自繳納。

11. 雜項

除「歷史及公司架構」、「財務資料」及本附錄各節所披露者或與[編纂]有關者外，

- (i) 據我們所知，於緊接本文件日期前兩年內，
 - (a) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何繳足或部分繳付代價的股份或借貸資本(不論以現金或現金以外的代價)；及
 - (b) 本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而授出佣金、折扣、經紀佣金或授予其他特別條款；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權或有條件或無條件同意將附有購股權；
- (iii) 概無就認購或同意認購，或促使或同意促使認購本公司或其任何附屬公司任何股份而支付或應付任何佣金；
- (iv) 並無豁免或同意豁免未來股息的安排；
- (v) 於緊接本文件日期前12個月內，我們的業務並無出現任何可能對本集團財務狀況造成或已造成重大影響的中斷；及
- (vi) 本公司並無任何尚未行使的可換股債務證券或債權證。